



TIC®800K-A1 系列是一种高性能、高成本利用率的导热界面材料，它独特的晶粒方向性，板材结构允许它和表面确切的相一致，从其热转换作用被放大。在高于它的转变温度50℃，TIC系列开始软化相变，可以填充到器件微小的不规则接触面上，形成一个小接触热阻的界面，达到良好的散热效果。

特性

- 》低热阻
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》低压力应用环境

应用

- 》功率转换设备
- 》电源与车用蓄电池
- 》大型通信开关硬件
- 》LED电视，灯具
- 》笔记本电脑

TIC® 800K-A1 系列特性表			
产品特性	TIC® 805K-A1	TIC® 806K-A1	测试方法
成份	非硅热塑性材料/聚酰亚胺		-
颜色	黄色		Visual
厚度范围 (inch/mm)	0.005/0.125	0.006/0.150	ASTM D374
密度 (g/cc)	2.0		ASTM D792
建议使用温度范围	-40~150		-
击穿电压 (V/mm)	5000		ASTM D149
介电常数 (@1.0MHz)	4.5		ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	1.0*10 ¹²		ASTM D257
导热系数 (W/mK)	1.5		ASTM D5470
	1.5		ISO22007-2.2
热阻抗 (°C·in ² /W)	0.20	0.21	ASTM D5470
相变温度 (°C)	50~60		-

产品规格

标准厚度:

0.005inch(0.125mm) / 0.006inch(0.150mm)。

标准尺寸: 10"×100'(254mm×30.48m)。

TIC系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

产品型号说明

TIC8 00 - A1

